



첨단 PCB 제품 국제표준 선점 전략 마련

10월 16일 서울에서 개최된 전자조립기술 (IEC/TC91) 국제표준화 회의를 계기로

세계시장 4위인 국내 PCB 산업의 미래 경쟁력 강화를 위해 산업자원부에서 수립한 PCB 산업발전 전략을 바탕으로 국제표준화선점을 위한 전략적 표준화가 추진될 전망이다.

산업자원부 기술표준원은 기술력격차와 가격 경쟁 문제를 타개하고 친환경 PCB, 플렉시블 PCB, 광 PCB 등 차세대 제품 경쟁력 강화를 위해 우리기술의 국제표준 제안, 국제표준화 리더 그룹과의 협력 강화 등 전략적 표준화를 적극 추진할 예정이라고 밝혔다.

이 일환으로 우선, 기술표준원은 최신의 국제표준기술을 국내에 전파하고 표준화 인력풀 확대를 통한 국제표준화 선도의 토대를 구축하기 위해 10월 16일(화)부터 4일간 서울올림픽파크텔에서 "07년도 전자 조립기술(IEC/TC91) 국제표준화 회의"를 유치하여 개최했다.

이번 회의에서는 친환경 PCB 생산 개발을 위한 솔더(땀납) 재료의 함유기준치 및 시험방법 등 최신 표준화 작업이 이루어졌으며, 표면 실장기술 및 전자제품의 신뢰성 확보를 위해 PCB의 기계적 충격시험방법, 마찰시험방법 등 다양한 표준도 논의되었다.

우리나라 PCB 산업은 세계시장 규모의 11.1%(세계시장 500억불)에 달하며, 국내생산규모는 '06년 기준으로 5조원을 상회하여 세계시장 4위를 점유하고 있지만, 가격경쟁 등 주변국의 견제가 심화되고 있는 실정이어서 새로운 돌파구 마련이 긴요하다는 목소리가 높다.

※ 세계시장 점유율(%) : 중국 27.6, 일본 22.2, 대만 16.5, 한국 11.1, 미국 9.4

이러한 상황에서 세계 1,2위를 탈환하기 위해서는 차세대 PCB에 대한 기하급수적인 수요증가에 대비하고, 전략 기술력

우위를 바탕으로 국가 표준화를 통한 효율성, 호환성 확보와 함께 국제표준을 선도하는 전략 마련이 필수적이라 할 수 있다.

이를 위해 한국전자회로산업협회(KPCA)를 주축으로 국내 기업 및 전문가들로부터 세계 일류 수준의 표준화 아이টে를 발굴하고 전자부품연구원 등 국내 전문연구기관의 연구결과를 국제표준에 적극 반영함으로써 국제표준 선도를 위한 토대를 마련한다.

기술표준원측은 이번 서울 국제회의를 계기로 우리기술의 효율적 표준화 추진체계를 구축하고 국제표준제안 확대 및 핵심기술보유 국가와의 국제표준협력을 통해 취약한 가격경쟁력을 조기 극복하고 차세대 PCB산업의 기술 경쟁력 강화를 지속적으로 추진해 나아갈 예정이며, 앞으로 그간의 단순한 IEC 국제표준 도입 전략을 넘어 국제표준 리더의 관점에서 종합적 표준화 대책도 수립하여 추진함으로써 정부가 추진하는 2015년 세계 PCB 1위국 부상의 견인차 역할을 할 계획이다.

- ※ 붙임 : 1. 표준을 통한 PCB 산업 선진화 추진계획[요약]
- 2. 전자조립기술(IEC/TC91) 국제표준화 동향 및 '07년도 총회 개요

표준을 통한 PCB 산업 선진화 추진계획

1. 표준화 추진체계 구축

□ PCB(IEC/TC91)분야 표준화 대응체계 개선

- 관련 산·학·연·단체와의 네트워크 구축을 통한 표준화 대응

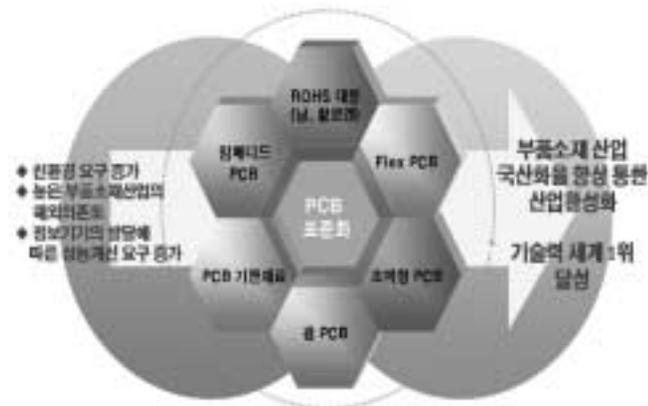
- 전자회로산업협회(간사기관) 및 유관기관을 바탕으로 표준화 유관 기관 육성지원 및 기업의 참여 유도

- 국제표준화회의 적극 유치 및 우리기술 국제표준반영과 국제표준 리더그룹 수임을 전략적으로 추진하여 인력풀 확대



2, 표준화 활동 계획

- 기술표준 표준화 활동 로드맵을 수립하여 표준화 추진
- 국내 PCB 제조산업의 발전을 위하여 반드시 확보해야 하는 핵심요소기술 위주로 표준화 추진('07~'15)
 - 표준화 저변확대를 위한 국제표준화 회의 12회 개최 및 세미나 3회
 - 한국산업규격 선진화 : 제정 34종, 폐지 7종
 - 국제표준화 선점을 위한 기술제안 12건 등
- 표준화 이슈인 PCB의 친환경성 고려 표준 및 차세대 PCB 관련 국제표준을 단계적으로 KS로 도입



전자조립기술 국제표준화 동향 및 '07년 IEC/TC91 총회 개요

1, PCB 분야 표준화 동향

- PCB의 국제표준화는 PCB재료, 표면실장기술, 친환경성 등을 주요 이슈화 하여 표준화 작업이 진행중임
- PCB 제품과 조립공정 등 전자조립기술 관련 국제규격은 IEC/ TC91(전자조립기술)에서 작업중임
 - 제정 : 76종, 작업중 : 35종(개정 포함)

- PCB분야 KS 규격은 “무할로겐 PCB재료” 등 총 66종 제정되어 있음
- IEC 국제규격 도입(IDT) 51종, 국제규격 수정도입(MOD) 10종, 국내고유규격(NEQ) 5종
 - ※ "인쇄회로기판 재료분야" 4종 KS 제정 추진 중
- 단체규격으로 한국전자산업진흥회(KEA) 규격(23종), 일본전자산업진흥회 (JEITA) 규격(40종)이 있음

2, '07년도 전자조립기술(IEC/TC91) 국제표준화 회의 개요

- 회의개요
 - 회의명 : “전자조립기술(IEC/TC91) 국제표준화 회의”
 - 회의기간/장소 : '07.10.16(화)~10.19(금)/서울올림픽파크호텔
 - 참가예상규모 : 독일, 일본 등 5개국 50여명
 - 주최/주관 : 산자부 기술표준원/한국전자회로산업협회 (KPCA)